

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年2月10日 (10.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/013346 A1

(31) 国際特許分類:

H01L 21/306

(72) 発明者; および

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/010808

(75) 発明者/出願人(発明についてのみ): 宮崎 正光
(MIYAZAKI, Tadamitsu) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川
県平塚市四之宮3丁目25番1号 コマツ電子金属
株式会社内 Kanagawa (JP). 平山 和也 (HIRAYAMA,
Kazuya) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮
3丁目25番1号 コマツ電子金属株式会社内 Kana-
gawa (JP). 福永 寿也 (FUKUNAGA, Hisaya) [JP/JP]; 〒
2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号 コ
マツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP). 二村 公尚
(FUTAMURA, Hiroyasu) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県
平塚市四之宮3丁目25番1号 コマツ電子金属株
式会社内 Kanagawa (JP).

(22) 国際出願日:

2004年7月29日 (29.07.2004)

(74) 代理人: 木村 高久, 外(KIMURA, Takahisa et al); 〒
1040043 東京都中央区銀座1丁目8番11号 千代ビル
6階 Tokyo (JP).

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

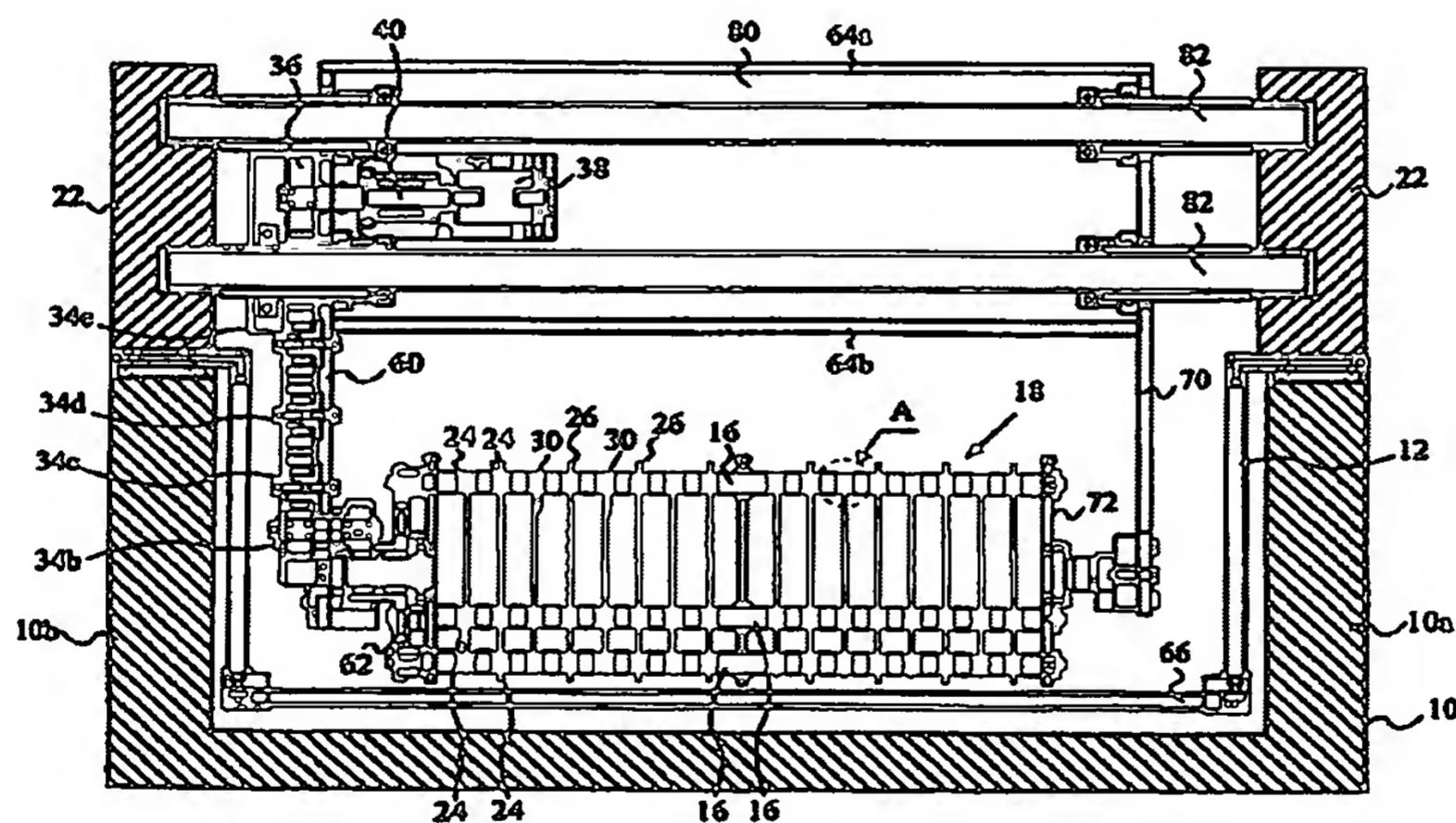
特願2003-204248 2003年7月31日 (31.07.2003) JP

(71) 出願人(発明を除く全ての指定国について): コマツ
電子金属株式会社 (KOMATSU DENSHI KINZOKU
KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平
塚市四之宮3丁目26番1号 Kanagawa (JP).

(複数有)

(34) Title: METHOD AND APPARATUS FOR ETCHING DISK-LIKE MEMBER

(34) 発明の名稱: 内板状部材のエッティング方法及び装置



WO 2005/013346 A1

(57) Abstract: Disclosed are a method and apparatus for etching disk-like members, especially a method and apparatus for etching semiconductor wafers. In a method wherein wafers (30) are rotated and etched in an etching chamber (12) which is filled with an etching solution, a non-rotating cell plate (26) is disposed between two rotating wafers (30). In an etching apparatus wherein multiple wafers (30) are supported and rotated by a rod (16), a cell plate (26) is disposed between each two wafers (30). The cell plate (26) has a surface area roughly equivalent to that of the wafer (30).

(57) 著約: 本願発明は、内板状の部材のエッティング方法及びエッティング装置に係り、特に、半導体ウェーハのエッ
ティング方法及びエッティング装置に関するもの。 エッティング液を満たしたエッティング箱(12)の内部で、ウェーハ(

(複数有)